



2026

핵테온 세종

AI·사이버보안 콘퍼런스

2026. 7. 9(목) - 10(금) | 정부세종컨벤션센터

# 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회

홈페이지  
바로가기



일 자 2026년 7월 9일(목) ~ 10일(금)

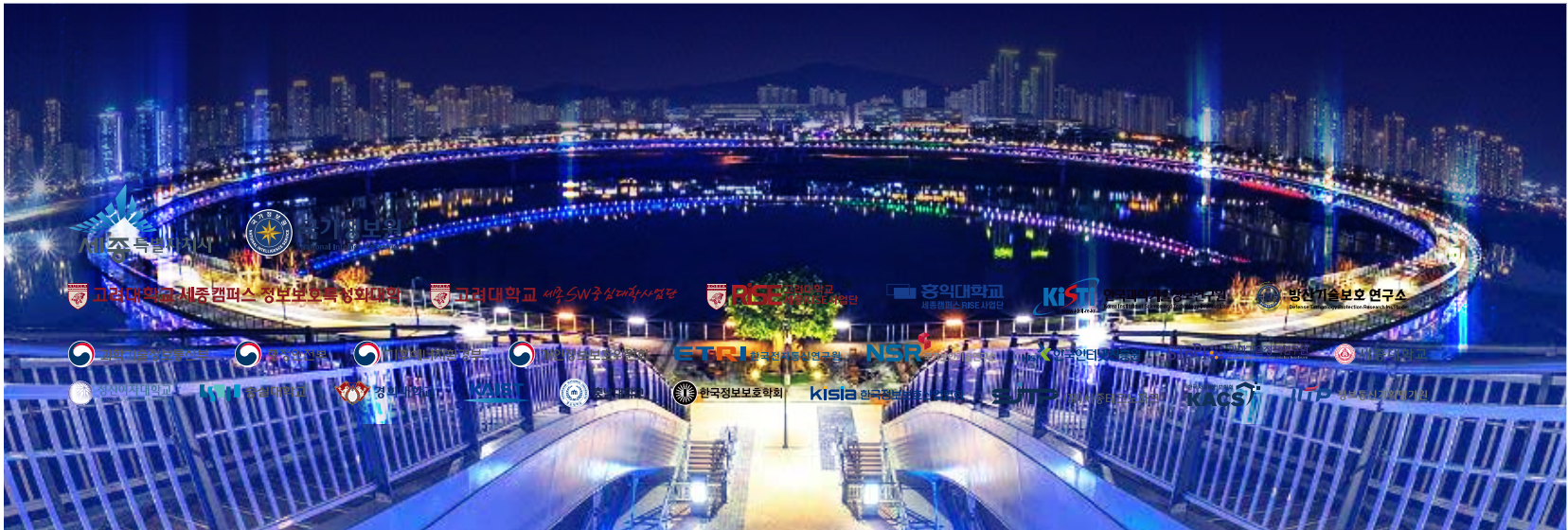
장 소 정부세종컨벤션센터 2층 기획전시장

주 최 세종특별자치시 국가정보원

주 관 고려대학교 세종캠퍼스 정보보호특성화대학 고려대학교 세종 SW중심대학사업단 RISE 고려대학교 세종 RISE사업단 홍익대학교 세종캠퍼스 RISE사업단 KISTI 한국과학기술정보연구원 방산기술보호 연구소

후 원 과학기술정보통신부 행정안전부 기후에너지환경부 개인정보보호위원회 ETRI 한국전자통신연구원 NSR 국가방안기술연구원  
 KISA 한국인터넷진흥원 STePI 과학기술정책연구원 세종대학교 성신여자대학교 KSII 숭실대학교 경희대학교 KAIST 충남대학교  
 한국정보보호학회 kisia 한국정보보호산업협회 SJTP (재)세종테크노파크 KACS IITP 정보통신기획평가원

전시대행사 CM 주식회사 컬처메이커스



## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 부스참가 안내

### 참가비용 안내

부스타입	제공내역	참가비(VAT포함)
조립부스 (3m*3m)	전시면적 + 조립부스(옥타) 장치 제공 최소 1부스 이상 참여 비즈니스 매칭 참가 가능 (2부스 이상 참여 신청기업 기술 설명회 발표 세션 우선순위 배정)	3,300,000원
		* 전년도 전시 참여기업 할인(10% 적용) 3,000,000원
독립부스 (6m*3m)	전시면적만 제공(기업에서 자체 맞춤형 디자인 부스 구축 가능) 최소 2부스 이상 참여 비즈니스 매칭, 기술 설명회 발표 세션 참가 가능	6,600,000원
		* 전년도 전시 참여기업 할인(10% 적용) 6,000,000원

\* 참가비는 부가세(VAT)포함 금액

\* 1부스 : 9m<sup>2</sup> = (3m × 3m)

\* 부스배정원칙 : 참가신청서 접수, 참가비 납입 확인 후 부스위치 지정 가능

### 전시배치도



부스 제공내역

조립부스 : 1부스(3m × 3m) 기준			독립부스 : 1부스(3m × 3m) 기준 면적	
 <p>정면</p>	 <p>물자배치</p>	 <p>측면</p>		

조립부스 : 1부스(3m × 3m) 기준		독립부스 : 1부스(3m × 3m) 기준 면적	
부스 장치(옥타늄 시스템)	1set [9m <sup>2</sup> = (3m × 3m)]	파이텍스	2set [18m <sup>2</sup> = (6m × 3m)]
간판	1set	전기간선	2개
조명(암스팟)	6개	콘센트 2구	2개
전기간선	1개	* 독립부스의 경우 2부스 이상의 기준 면적 신청만 가능하며, 제공되는 내역을 제외하고 자유로이 면적 내 시공이 가능합니다. 단 부스의 높이는 3.5미터가 넘어가지 않도록 제작 부탁드립니다.	
콘센트 2구	1개		
미팅테이블	1개		
미팅의자	4개		
인포테스크	1개(가로1m×높이1m, 그래픽 포함)		
파이텍스	1set [9m <sup>2</sup> = (3m × 3m)]		



## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 부대행사 안내

### 전시기업 기술설명회

일 정	2026년 7월 10일(금), 14시 ~ 15시 30분
장 소	2층 기획전시장 내 컨퍼런스홀
주 요 내 용	기업 및 주요 기술, 제품 설명을 통한 기업 이미지 제고 및 홍보
신 청 방 법	기업 기술 전시회 참가 신청서 내 참여 프로그램 체크 후 제출(전시부스 2개 이상 신청기업 우선 순위 배정)

### 비즈니스 매칭 프로그램

일 정	2026년 7월 10일(금), 11시 ~ 18시
장 소	4층 VIP라운지
주 요 내 용	최적의 비즈니스 파트너 초청 및 비즈니스 매칭 상담회 운영, 네트워킹의 場 마련
신 청 방 법	기업 기술 전시회 참가 신청서 내 참여 프로그램 체크 후 제출



## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 참가신청서

### 참여기업 정보

기관명	국문		영문	
주소				
대표자명			홈페이지 주소	
담당자	성명		대표번호	핸드폰
	부서/직위		팩스번호	이메일
참여 프로그램	<input type="checkbox"/> 기업전시 <input type="checkbox"/> 기술설명회 <input type="checkbox"/> 비즈니스 매칭			

### 부스신청

부스타입	제공내역	참가비(VAT포함)	신청수량	금액(VAT포함)
조립부스 (3m*3m)	전시면적 + 조립부스(옥타) 장치 제공 최소 1부스 이상 참여	3,300,000원	( )부스	원
		* 전년도 전시 참여기업 할인(10% 적용) 3,000,000원	( )부스	원
독립부스 (6m*3m)	전시면적만 제공 (기업에서 자체 맞춤형 디자인 부스 구축 가능) 최소 2부스 이상 참여	6,600,000원	( )부스	원
		* 전년도 전시 참여기업 할인(10% 적용) 6,000,000원	( )부스	원

- \* 부스배정은 참가 업체 규모 및 사업 분야에 따라 접수 완료 후 배정됩니다.
- \* 기본제공 비품 외 추가 비품은 별도로 신청해 주셔야 합니다. (신청기업 담당자에게 별도 안내)
- \* 참가신청서 작성 후, 사업자등록증과 회사 로고 ai 파일 및 png 파일을 첨부하여 제출해 주시기 바랍니다. (hacktheon2026@cmcom.kr)
- \* 참가비는 핵테온 전시대행사(컬처메이커스)를 통하여 납부하여 주시기 바랍니다.
- \* 참가비 납부계좌 : 신한은행 140-010-359803 / 예금주 : (주)컬처메이커스(전시대행사)

## 개인정보 수집·이용·제공 동의

세종특별자치시에서는 「2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회」 운영을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용·제공 하고자 합니다.

### <개인정보 수집·이용 동의>

- 수집·이용 목적 : 전시자 신청확인, 전시회 홍보 및 운영
- 수집 항목 : 기업명, 주소, 대표자명, 홈페이지 주소, 담당자(성명, 대표번호, 핸드폰, 부서/직위, 팩스번호, 메일)
- 보유 및 이용기간 : 수집일로부터 1년
- 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 본 전시회 참가신청에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까?    동의함    동의하지 않음

### <개인정보 제3자 제공 동의>

- 수집된 개인정보는 전시대행사에게만 제공되며, 법령에 따라 허용되지 않는 한 제3자에게 제공되지 않습니다.
- 제공받는 기관: (주)컬처메이커스
- 제공목적 : 전시자 신청확인, 전시회 홍보 및 운영
- 제공항목 : 기업명, 주소, 대표자명, 홈페이지 주소, 담당자(성명, 대표번호, 핸드폰, 부서/직위, 팩스번호, 메일)
- 보유 및 이용기간 : 수집일로부터 1년
- 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 본 전시회 참가신청에 제한을 받을 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는데 동의하십니까?    동의함    동의하지 않음

당사는 「2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회」 출품규정 및 계약조건(이면 수록)을 수락, 상기와 같이 출품신청 및 계약체결을 하고자 합니다.

2026년   월   일 | 신청인(대표자) 성명:                      (인/서명)

## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 출품규정 및 계약조건

### 제1조(용어의 정리)

1. 전시자라 함은 본 전시회 참가를 위하여 참가신청과 함께 계약금을 납부한 개인, 회사, 기관 및 단체 등을 말한다.
2. 전시회라 함은 2026년 HackTheon Sejong 기업기술 전시회를 말한다.
3. 주최사라 함은 세종특별자치시, 주관사라 함은 고려대학교 세종캠퍼스, 전시대행사라 함은 (주)컬처메이커스를 말한다.

### 제2조(참가신청 및 계약)

1. 전시회 참가신청을 하고자 하는 전시자는 전시대행사에서 안내하는 참가신청서를 메일 또는 전시대행사에서 안내하는 온라인 신청폼을 통해 접수함을 원칙으로 한다.
2. 전시장 면적이 소진된 경우와 출품할 품목이 전시회에 적합하지 않다고 판단될 경우 주관사는 신청 접수를 거부할 수 있다.
3. 전시자는 참가신청서 제출 후 참가비를 납부하여야 참가 자격이 주어진다.

### 제3조(전시위치 배정)

1. 주관사는 계약금 납입 순서, 참가 규모 외 전시품 성격 등에 의거하여 부스를 배정하는 것을 원칙으로 하되, 전시장의 공간조화와 관람효율 및 전시 효과 등을 고려하여 참가업체의 전시 위치를 배정하고 전시자는 이에 이의를 제기할 수 없다.
2. 주관사는 불가피한 사정이 발생할 경우, 장치설치 전에 전시자에게 할당된 공간의 위치 또는 크기를 변경할 수 있으며 전시자는 이에 따른 이의를 제기하거나 보상을 청구할 수 없다.

### 제4조(전시품 제한 및 전시부스 관리)

1. 전시자는 참가신청서에 명시한 전시품을 전시하고, 상주 인원을 배치하여 자사 부스 관리에 만전을 기하도록 한다.
2. 전시자가 참가신청서에 명시한 전시품과 상이한 물품을 전시하거나 전시회 성격에 부합되지 않는 물품을 전시할 경우 주관사는 즉시 중지, 철거 또는 반출을 명할 수 있다. 이 경우 참가비는 반환되지 아니하며 전시자는 이에 따른 배상을 청구할 수 없다.
3. 주최 및 주관사는 필요한 경우 특정인의 전시장 출입을 제한할 수 있다.
4. 전시자는 주관사의 서면동의 없이 배정된 전시면적의 전부 또는 일부를 타인에게 양도할 수 없다.
5. 전시자는 주관사가 허가한 공간 이외에서는 일체의 판매행위를 할 수 없다.
6. 주최 및 주관사는 질서 유지와 안전관리, 사회적 물의를 유발할 수 있는 행위 예방 등을 위하여 품목 및 전시행위 등을 선택적으로 배제 또는 제한할 수 있다.
7. 주관사는 지적재산권을 침해하는 전시품에 대해 반출을 명할 수 있다.
8. 주관사의 사전허가 없이 불허된 전시품을 전시 또는 판매하였을 경우 주관사는 참가를 취소할 수 있으며, 전시자는 이에 대해 일체 이의를 제기할 수 없다.



## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 출품규정 및 계약조건

### 제5조(해약)

1. 전시자가 신청한 전시 부스의 전부 또는 일부의 사용을 포기 또는 거부하거나 참가비를 기한 내 납부하지 않을 경우, 주관사는 일방적인 참가신청서를 해지할 수 있으며, 이 경우 기 납입된 참가비는 반환하지 않는다.
2. 전시자가 참가신청서 제출 후 참가를 취소할 경우 아래에 정한 위약금을 참가 취소 신청 후 15일 이내에 전시대행사에 납부하여야 한다.  
(단, 기 납입된 참가비는 동 해약금으로 차감하며, 부족 시 추가 납입하고, 잉여 시 반환한다.)

구분	내용
행사개막 40일 이전	참가비 전액의 50%
행사개막 전 39일 이내	참가비 전액의 100%

### 제6조(전시회의 취소 및 변경)

주최 및 주관사가 국가 위기 상황이나 전염병, 천재지변 등 불가항력적인 상황 또는 기타 주최자의 귀책(歸責)사유가 아닌 특별한 사정으로 개최일 및 장소를 변경하거나 축소 또는 취소하는 경우, 전시자는 참가 신청과 관련한 보상을 청구할 수 없다. 또한, 필요하다고 판단되면 주최 및 주관사는 전시회의 기간과 개장시간을 변경할 수 있다. 이러한 사유로 발생 된 손상이나 손해에 대한 보상은 없으며 이러한 이유로 참가 신청 계약을 취소할 수 없다.

### 제7조(장치 및 전시품 진열)

전시자는 배정된 전시면적 내에 지정 기간 내 장치 및 전시품 반입, 진열을 완료하여야 한다. 또한, 전시자는 전시공간의 바닥, 천장, 기둥, 면적, 부스 등에 페인트칠, 스티커 부착 등 부스 훼손 또는 변경을 할 수 없으며, 전시장의 손해에 대해서는 원상복구 등 주관사의 손해를 배상하여야 한다.

### 제8조(사진 및 영상 촬영)

1. 주최 및 주관사, 전시대행사는 전시장에서 이루어지는 모든 이벤트, 부스, 전시품에 대하여 미디어 홍보를 목적으로 하는 사진 및 영상 촬영을 할 수 있다.
2. 주최 및 주관사는 홍보를 목적으로 해당 영상 또는 사진을 재가공 혹은 업로드 할 수 있다.

### 제9조(전시품 및 장치물 반출)

1. 전시자는 전시회 종료 전에 전시품을 반출할 수 없다.
2. 전시자는 지정 기간 내에 모든 전시품 및 장치물을 반출하여야 하며, 반출을 지연할 경우, 전시대행사 측이 부담하게 될 제반 비용을 즉시 전시대행사에게 납입하여야 한다.

## 2026 HackTheon Sejong 기업기술 전시회 출품규정 및 계약조건

### 제10조(전시장 경비, 위험부담 및 보험)

1. 전시자는 전시기간은 물론 설치 및 철거기간 동안 모든 설비 및 전시 도난, 파손, 분실 등에 대비하여 반드시 보험에 가입하여야 한다.
2. 주관사 및 전시대행사는 전시자 및 참관객의 안전과 재산을 보호하기 위하여 전시장 경비 등 적절한 경계조치를 하지만, 전시자의 모든 물품에 관한 궁극적 책임은 전시자 스스로에게 있으며, 도난, 파손, 분실 등에 대한 책임은 전시자가 스스로 부담한다.

### 제11조(방화규칙)

1. 장치물 및 전시장 내의 모든 자재는 소방법규에 따라 적절한 불연처리가 되어야 한다. 또한, 방염 합판에 붙어있는 필증 손상은 금지한다.
2. 주최사 및 주관사 필요에 따라 전시자에게 화재방지와 관련한 시정을 요구할 수 있다.

### 제12조(보충규정)

1. 주관사가 필요한 경우 참가규정에 명시되지 않은 보충규정을 제정할 수 있으며, 전시자는 이를 준수하여야 한다.
2. 전시자는 2026 HackTheon Sejong 기업전시의 참가규정과 정부세종컨벤션센터의 규정을 준수하여야 한다.

### 제13조(분쟁해결)

본 참가규정의 해석에 관하여 주최 및 주관사, 전시대행사와 참가자 간의 이견이 발생하는 경우, 주관사의 해석에 우선하며 이에 관한 분쟁은 대한상사중재원의 중재판정에 따르고, 그 판정에 대하여는 법원에 제소할 수 없다.